

HRG300

High Rigid Grinder

高剛性研削盤

短時間でダメージのない加工を実現

低加工コスト

バッチ加工で高精度研削が可能

常時ドレスの精研削プロセス（オプション）





対象材料

サファイア SiC GaN AlN 等の難削材

対象ワーク

サイズ：φ2～φ12インチ
最大厚さ：20mm（支持基板の厚さを含む）

加工事例

材料	サイズ	枚数/バッチ	取代	加工時間
サファイア	4インチ	4枚バッチ	530μm	10分(2分30秒/枚)
SiC	4インチ	枚葉	120μm	1分
窒化アルミ	6インチ	枚葉	500μm	4分

仕様



項番	項目	ACCRETECH
		高剛性研削盤
1	外観 (mm)	サイズ：1540(W)X 1880(D)X 2010(H) 重 さ：3850kg
2	最大加工径 (mm)	300
3	砥石径 (mm)	300
4	砥石軸回転数 (rpm)	3600
5	ワーク軸回転数 (rpm)	400
6	砥石軸モータ (Kw)	11
7	ワーク軸モータ (Kw)	2
8	自動計測	インプロセスゲージ採用 (バッチ処理対応)
9	送り制御最小分解能 (μm)	0.01
10	常時ドレス機能	オプション

